



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090329000  
2009年4月7日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 品質保証部 カスタムドキュメント  
マネージャ 牧 達郎

TMS320C32 製品 前処理サイト変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	TMS320C32製品 前処理サイト変更 現行：TI-MIH06(日本)サイト 変更後：TI-HIJI(日本)サイト			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	7月中旬の出荷より予定しています。 (サンプルは、5月中旬を予定しています。)			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは[pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com)にお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) TMS320C32製品 前処理サイトについて、現行 TI-MIH06(日本)サイトにて製造いたしておりますが、TI-MIH06サイト製造終了の為、これに替えて、TI-HIJI(日本)サイトでの製造に移行し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	TI-MIH06(日本)	TI-HIJI(日本)

理由：TI-MIH06 サイト製造終了の為

対象製品リスト

対象製品名				
5962-9679001NXB	SM320C32PCMM50EP	TMS320C32PCM40	TMS320C32PCM60	TMS320C32PCMA40CT
5962-9679002NXB	SM320C32PCMM60EP	TMS320C32PCM50	TMS320C32PCMA40	TMS320C32PCMA50

製品表示

この変更に伴い、製品捺印の FAB CODE が "H" (TI-MIH06) から "J" (TI-HIJI) に変更されます。

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	TMS320C32PCM40	Die Size(mils) :	1102.36 X 1102.36
Wafer Fab Site:	HIJI	Wafer Technology	50C18.23
Assembly Site:	TIPI	Package Type/Code/Pin:	QFP/PCM/144
Mount Compound:	HITACHI EN4085S2K3	Mold Compound:	SHINETSU KMC188-1
MSL:	JEDEC LEVEL4-245CP	Leadframe Base/Finish:	Cu, NiPdAu

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
Latch-up	+/-200 mA, 1.5Vcc	5/0	-	-
ESD - HBM	500V, 1000V, 1500V, 2000V	3/0	-	-
**Temperature Cycle	-65/150C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240Hrs	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 200 Cyc	75/0	72/0	72/0
**High Temp Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0

Note: \*\* Moisture preconditioning required, JEDEC L-4/245C